

2026年度 多元技術融合光プロセス研究会 第1回研究交流会プログラム

次世代半導体産業に求められるレーザー

【日時】2026年7月23日(木) 10:00-17:20

【場所】ハイブリッド開催(中央大学 後楽園キャンパス3号館14階セミナールームA, B+オンライン)

<https://www.chuo-u.ac.jp/access/kourakuen/>

【担当幹事】平等 拓範(理研/核融合研/中央大)

小西 邦昭(東京大学)

古田 啓介(三菱電機株式会社)

【プログラム案】(敬称略)

代表幹事挨拶	杉岡 幸次(理化学研究所)	10:00-10:05
企画趣旨説明	第1回研究交流会 担当幹事	10:05-10:10
講演1	「EUV リソグラフィのロードマップ(仮)」 溝口 計(九州大学)	10:10-10:55
	[概要]	
講演2	「エキシマレーザーの最前線とその次(仮)」 半井 宏明(ギガフォトン)	10:55-11:40
	[概要]	
講演3 特別講演	「半導体産業・技術の最近動向と今後課題など」 日高 秀人	13:00-14:00
	[概要] 文科省系半導体研究拠点形成プロジェクトやエッジAI半導体研究プロジェクトの概観と課題	
講演4	「半導体検査用光源(仮)」 三宅 伸一郎(レーザーテック)	14:00-14:45
	[概要]	
講演5	「次世代半導体3次元実装・チップレットの今後の展開と求められるレーザー技術」 知京 豊裕(NIMS)	15:00-15:45
	[概要]	
講演6	「超短パルスレーザーによるガラスビア加工(仮)」 谷 峻太郎(理研)	15:45-16:30
	[概要]	
講演7	「先端半導体パッケージング技術の最新動向(仮)」 田丸 博晴(東京大学)	16:30-17:15
	[概要]	
次回研究会の案内	第2回研究交流会 担当幹事	17:15-17:20

※プログラムは変更する場合があります。最新情報は研究会HPにてご確認ください。

【参加費】

本研究会会員、及び会員からの紹介者：無料(正会員8人回、準会員4人回まで無料)
一般20,000円/人

【意見交換会】

17:30-19:30 意見交換会を開催します。会員相互の交流、講師や幹事との気軽なディスカッションにご活用いただけますので、是非ご参加ください。参加費は無料ですが都合により変更する場合がございます。

【研究交流会への参加申込み方法】

第1回研究会に参加される方は以下のFormsよりご記入の上、お申し込みください。

<https://forms.office.com/r/FcTnPCZbf5>

会員からのご紹介でご参加される方は、ご自身のお名前及びご紹介いただいた会員のお名前も併せてご記入ください。

【研究会への新規入会申込み方法】

研究会へ新規に入会される方は研究会HPの入会申込書をご確認の上、お申し込みください。

<https://www.oitda.or.jp/study/mt/>

【事務局】 一般財団法人光産業技術振興協会

〒162-0801 東京都新宿区山吹町346-6 KAGURAZAKA VIGAS 2階

Email : tagen.proc@oitda.or.jp TEL : 03-5225-6431 FAX : 03-5225-6435

研究会HP : <https://www.oitda.or.jp/study/mt/>